

令和7年2月17日

関係各位

(一社) 日本実装技術振興協会  
会長 嶋田 勇三

## 第231回定例講演会のお知らせ

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

さて、日本実装技術振興協会の第231回定例講演会の内容が決まりましたのでお知らせいたします。

今回は会場とWEB会議システム（Zoom ウェビナー）を利用したハイブリッド開催となります。

ご多忙の中恐縮ではございますが、万障お繰り合わせの上、ご参加下さいますようお願い申し上げます。ホームページでも同定例講演会の情報を配信します。

敬具

記

1. 開催日時：令和7年3月19日（水）定例講演会 13：00～16：40  
技術交流会 17：00～18：00

2. 開催方式：ハイブリッド方式

【川崎市産業振興会館第3研修室+WEB会議システム「Zoom ウェビナー」】

（Zoom参加を申し込みされた方には後日、招待メールをお送りします）

川崎市産業振興会館：神奈川県川崎市幸区堀川町66番地20

<https://kawasaki-sanshinkaikan.jp/>

3. プログラム：“産学官連携特別企画『横浜を中心とした半導体関連特集』”

|                              |   |
|------------------------------|---|
| (1) 13:00～13:30<br>プログラムテーマ① | 『横浜市の立地環境と半導体関連企業の集積について』<br>横浜市経済局ビジネスイノベーション部 企業投資促進課企業誘致・立地担当課長<br>島山 幹貴 氏<br>講演内容：横浜には、利便性の高い交通ネットワーク、緑豊かな住環境、大学・学術研究開発機関の集積、豊富な人的資源などが整っている。本講演では、これら企業のイノベーションに貢献する、横浜のビジネス環境について、近年の半導体関連企業の集積状況等を交えながら紹介する。   |
| (2) 13:30～14:20<br>プログラムテーマ② | 『横浜を半導体エコシステム拠点に！—研究開発と人材育成の取り組み紹介—』<br>横浜国立大学 半導体・量子集積エレクトロニクス研究センター 副センター長<br>井上 史大 氏<br>講演内容：AI 向け半導体集積技術として「チップレット」に大きな注目が集まっている。特に将来的なAIアーキテクチャーでは接合界面にCu-Cuハイブリッド接合を用いることでより低消費電力化、寄生容量に起因するレイテンシーの最小化が試みられている。将来的なチップレットの構造は微細な界面はハイブリッド接合、大きなダイ同士の接続は引き続きインターポーザを使った2.5D接続、その外には光インターコネクトといった配線の役割分担をさせる構造が現実的な案として出てきている。また横浜ではこのチップレットに関するエコシステム型R&Dが同時多発的にスタートしている。講演では上記のチップレットに関する解説、横浜の半導体研究開発のポテンシャル、人材育成の取り組みについて解説する。        |
| (3) 14:20～15:10<br>プログラムテーマ③ | 『半導体産業集積地の役割と連携～YJCが目指すこと～』<br>横浜国立大学 大学院工学研究院 名誉教授 羽深 等 氏<br>講演内容：よこはま高度実装技術コンソーシアム（YJC）を紹介する。神奈川とその周辺には、半導体を含めて様々な先端産業があり、最先端の研究開発を進めている大学と研究機関がある。これは大学のシーズ、産業界のシーズと専門家の実践ノウハウが神奈川に存在することを意味している。即ち、大学、産業界と専門家が交流すれば深いレベルの擦り合わせと新たな技術が生まれるなど、新技術を育む土壌がある。そこで、YJCでは、エレクトロニクス実装技術における産学官連携を基に、①技術提供・交流としてYJC実装技術セミナーなど、②人材育成としてJISSOスクールと実装学会チュートリアルセッションなど、③研究開発プロジェクトとしてKAWOMEプロジェクトとEXPLOREプロジェクトを進めてきた。これらの活動から、YJCの歴史と特徴、目指していることを紹介する。 |

|                              |   |
|------------------------------|---|
| 15:10～15:20                  | — 休 憩 —   |
| (4) 15:20～16:00<br>プログラムテーマ④ | 『3次元実装を支援するチップレット・先端半導体パッケージシステム協調設計環境』<br>(株) 図研 技術本部 EL 開発部 シニアパートナー 松澤 浩彦 氏<br>講演内容：先端半導体の開発は、機能ごとに最適化したチップレットを3次元実装するアプローチへと進化しており、AIをはじめ、モバイルや車載用途でも注目されています。新しいチップレット3次元実装の課題は、従来の設計ツールや解析手法だけでは解決できず、協調設計が鍵になってきている。本講演では、同社の最新の取り組みを紹介する。 |
| (5) 16:00～16:40<br>プログラムテーマ⑤ | 『半導体のパッケージ組立と評価試験について（主にパワー系）』<br>シーマ電子（株） 設計試作評価センター 副センター長 小野寺 浩 氏<br>講演内容：パワーデバイスを中心に、基本的なパッケージ構造、組み立て方法、試験評価方法、課題と対処法を実際の装置などを見せて説明を行う。プロセス全体の基本を理解することで、課題解決の一助になると考える。また、はんだボイドの大きさや位置を組立プロセスのパラメータとし、パワーサイクル寿命への影響調査を行った研究例について報告する。       |
| 17:00～18:00                  | — 技 術 交 流 会 —<br>産業振興会館2階「カフェサウダージ」にて   |

#### 4. 参加費

会 員：無料 企業正会員は1社3名まで（Web会議特例：3名を超える参加者については事務局にお問い合わせください）。また、同じ名前とメールアドレスで複数人の方が入室した場合、システム上、同一人物が入室した人数分表示されます。1登録1名様のご利用でお申込みください。  
会員外：22000円/人（不課税）（お申し込み後、請求書をお送りします）

#### 5. 参加申し込み

会 員：会員は別途メールでお送りしているご出欠連絡用紙（企業正会員には登録代表者（連絡担当者）にお送りしています）にご記入の上、E-mailにてお申し込みいただけますようお願いいたします。

※今回、会場とZoomウェビナーのハイブリッド方式での開催となります。お申し込みの際は、参加者それぞれ、どちらの方式での参加をご希望か記載してください。

会員外：ホームページのお問い合わせフォーム（<https://www.j-jisso.org/p/contact.html>）より「お問い合わせ内容」の項目に第231回定例講演会参加希望の旨を記載してご連絡ください。参加方式（会場もしくはZoom）もご記載下さい。参加申込者と参加者が異なる場合、参加者のお名前とE-mailアドレスもご記入ください。

申込締切日：会 員 令和7年3月10日（月）

会員外 令和7年3月5日（水）

※講演2日前までに、ご参加者各人に招待メールをお送りしますので、ご参加者全員の氏名・メールアドレスをご連絡ください。また、Zoomウェビナーに参加される際には、ご連絡いただきましたメールアドレス・参加者氏名でログインするようお願いいたします。セキュリティの関係上、名簿と合致しない場合、Zoom定例講演会から退場していただく場合がございます。参加者が変更する場合はご連絡ください。

※講演資料は、講演日1週間前に郵便で発送させていただきます（企業正会員は登録代表者（連絡担当者）にお送りします）。

ご不明な点がございましたら下記までお問い合わせ下さいますようお願い致します。

事務局：一般社団法人 日本実装技術振興協会事務局 担当/相良(サガラ)・太田  
携帯：090-5403-1147 (相良)、090-5301-9467 (太田)

E-mail: [j.jisso.org@gmail.com](mailto:j.jisso.org@gmail.com) URL : <http://www.j-jisso.org/index.html>